

国内学学会発表 2005年度～2013年度

ECWC10 Conference at IPC Printed Circuits Expo, Anaheim, USA/Feb.21-24	
Characterization of Acid Copper Plating Solution for Via-Filling	○Hideki HAGIWARA、Ryoichi KIMIZUKA、Hideo HONMA
(社)表面技術協会 めっき部会創立50周年記念特別講演会 (2005、3 東京都鍍金工業組合)	
エレクトロニクス実装を支えるめっき技術	○本間英夫
第19回エレクトロニクス実装学術講演大会 (2005、3 東京理科大学)	
ピアフィリングに対する添加剤の電析依存性	○小山田仁子、本間英夫
ニッケル皮膜形態に及ぼすパラジウムフリー触媒化プロセスの影響	○角田貴徳、長島弘季、本間英夫、渡辺秀人
光触媒表面改質法を適用した導電性微粒子の作成	○田中公崇、田代雄彦、本間英夫、稲葉裕之、安部真二
光触媒を用いた平滑基板上へのメタライジング	○井上浩徳、石川久美子、藤村翼、田代雄彦、本間英夫、林亮
ガラス基板上へのエッチングレス直接無電解銅めっき	○岡崎克則、渡邊健治、中山香織、内田奈穂、本間英夫、田代雄彦
第111回表面技術協会学術講演大会 (2005、3 千葉工業大学)	
置換法によるアルミニウム上への無電解ニッケルめっき	○配島雄樹、齋藤裕一、柳沢英夫、田代雄彦、本間英夫
ホルマリンおよびグリオキシル酸を還元剤とする無電解銅めっきの特性	○依田健太郎、小山田仁子、王子雅裕、高井英次、飯田正、宮崎智行、本間英夫
めっき皮膜形成に及ぼす触媒化処理の影響	○長島弘季、角田貴徳、渡辺秀人、本間英夫
光触媒によるABS樹脂表面改質メカニズムの解析	○杉本将治、田代雄彦、小田倉尚子、別所毅、香西博明、本間英夫
光触媒によるABS表面改質後の密着改善	○八町利一、田代雄彦、家中徹、杉本将治、別所毅、本間英夫
TiO ₂ 光触媒およびUVを前処理に適用した有害物質フリープロセス	○田代雄彦、杉本将治、渡邊健治、別所毅、本間英夫
超音波パルス照射を用いた無電解ニッケルめっきによる近接場光学顕微鏡用プローブの作製	○齋藤裕一、加藤育洋、物部秀二、大津元一、本間英夫
電気ニッケルめっきによるバンプ形成時の電流密度の影響	○中丸弥一郎、角田貴徳、本間英夫
過マンガン酸フリービルドアップ材料への微細配線形成	○石川久美子、井上浩徳、藤村翼、渡邊健治、田代雄彦、別所毅、本間英夫
第72回電気化学会 (2005、4 熊本大学)	
無電解めっきによるポリイミド上へのメタライジング	○小田倉尚子、井上浩徳、田代雄彦、三浦修平、本間英夫
光触媒を用いた平滑基板上へのメタライジング	○井上浩徳、石川久美子、渡邊健治、杉本将治、別所毅、本間英夫
無電解ニッケルめっきによる近接場光学プローブチップ作製とサブミクロン領域におけるニッケル膜厚分布の制御	○加藤育洋、物部秀二、大津元一、本間英夫
マイクロファブリケーション研究会 第16回公開研究会 (2005、5 エレクトロニクス実装学会)	
エレクトロニクス実装を支えるめっき技術	○本間英夫
56th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (2005.9 Busan, Korea)	
Via-Filling by Copper Electroplating Using Current Waveform Control	○小山田仁子、小岩一郎、本間英夫
Effect of PEG Derivatives on Via-Filling by Copper Electroplating	○長島弘季、吉水裕貴、杉本将治、小山田仁子、本間英夫
Preparation of Anisotropic Conductive Particles Using Surface Finishing as photo-Catalyst Mechanism	○田中公崇、安部真二、本間英夫
Surface Modification of Insulation Resin for Build-up Process Using TiO ₂ as a Photocatalyst	○本間英夫

Effect of Palladium Free Catalyst Process on The Reliability of Solder Ball Joint	○角田貴徳、長島弘季、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
Analysis of Copper Crystal Structure in Filled Via	○萩原秀樹、君塚亮一、本間英夫
Influence of Additive Consumption to the Filling of Copper by Electroplating	○小田倉尚子、長島弘季、杉本将治、吉水裕貴、小山田仁子、本間英夫
Influence of Aluminum Surface Morphologies on Electroless Nickel Plating	○配島雄樹、齋藤裕一、小山田仁子、柳沢英夫、田代雄彦、本間英夫
Effect of Pyridinium Propylsulfonate on Bump Formation in Nickel Electrodeposition	○中丸弥一郎、角田貴徳、小岩一郎、本間英夫
Uniformity of Electroless Copper Plating for high Aspect through-Holes in PCB	○王子雅裕、井上浩徳、小山田仁子、飯田正、宮崎智行、本間英夫
Surface Modification of Insulating Flexible Resin Using UV and Alkaline for the Metallization	○石川久美子、井上浩徳、三浦修平、本間英夫
Surface Modification of Insulation Resin for Build-Up Process Using TiO ₂ as a Photocatalyst and Its Application to the Metallization	○井上浩徳、石川久美子、別所毅、本間英夫
Fabrication of Nickel Bumps Using Electroless Nickel Plating on Aluminum Alloys	○齋藤裕一、配島雄樹、小山田仁子、本間英夫
Surface Reforming of ABS Resin Using TiO ₂ under UV Light Irradiation	○杉本将治、田代雄彦、小田倉尚子、別所毅、本間英夫
Fabrication of a Near-Field Optical Probe by Electroless Nickel Plating	○加藤育洋、物部秀二、大津元一、本間英夫
New Production Process of Cathode Materials for Nickel-Zinc Primary Batteries	○寺島肇、加藤育洋、嶋川守、佐藤祐一、本間英夫
第112回表面技術協会学術講演大会 (2005、10 石川県地場産業振興センター)	
ピアフィリングに及ぼす添加剤の影響	○小田倉尚子、長島弘季、杉本将治、小山田仁子、小岩一郎、本間英夫
改質処理を用いたポリイミド上へのメタライジング	○石川久美子、小田倉尚子、井上浩徳、三浦修平、小岩一郎、本間英夫
厚付けノーシアン型無電解金めっきプロセス	○長島弘季、寺島肇、角田貴徳、小林未奈子、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
無電解Auめっきにおよぼす下地めっきの影響	○寺島肇、長島弘季、角田貴徳、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
アルミニウム合金上への置換法を用いた無電解ニッケルめっき	○齋藤裕一、配島雄樹、田代雄彦、小岩一郎、本間英夫
電気ニッケルめっきによるマイクロパンプ作成時の攪拌の影響	○中丸弥一郎、角田貴徳、小岩一郎、本間英夫
光触媒を用いた各種樹脂材料へのエッチング代替処理の影響	○杉本将治、田代雄彦、小田倉尚子、別所毅、小岩一郎、本間英夫
光触媒を用いたABS樹脂へのエッチング代替処理	○家中徹、田代雄彦、別所毅、小岩一郎、本間英夫
新規応力計によるめっき皮膜応力の経時的観察	○小山田仁子、高橋智賀子、秋山勝徳、山本渡、小岩一郎、本間英夫
塩化アンモニウムを用いた無電解ニッケルめっきとそのサイズ依存性	○加藤育洋、物部秀二、大津元一、本間英夫
第15回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(2005、10 大阪大学)	
光触媒を前処理に用いたビルドアップ絶縁材料への無電解銅めっき	○井上浩徳、石川久美子、別所毅、小岩一郎、本間英夫
無電解金めっき皮膜特性におよぼす下地めっきの影響	○角田貴徳、長島弘季、寺島肇、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
206th ECS (Meeting of The Electrochemical Society, Inc.) (2005 10, Los Angeles, USA)	
Preparation of Anisotropic Conductive Particles using a treatment as Photo-catalyst mechanism by electroless Ni plating	○田中公崇、稲葉裕之、小岩一郎、本間英夫
(社)表面技術協会 第64回武井記念講演会	
創造とセレンディピティー —表面処理における偶然の発見—	○本間英夫
第113回表面技術協会学術講演大会 (2006、3 東洋大学)	

スルファミン酸ニッケルめっき浴中のホウ酸の代替物質に関する検討	○和久田陽平、中丸弥一郎、角田貴徳、田代雄彦、小岩一郎、本間英夫
高アスペクト比スルーホールへの無電解銅めっきの適用	○樋口峰進、王子雅裕、小山田仁子、宮崎智行、依田健太郎、小岩一郎、本間英夫
新規応力計によるめっき皮膜応力のin-situ測定	○本橋甲子明、小山田仁子、山本渡、小岩一郎、本間英夫
UVによる改質処理を用いたポリイミド上への無電解めっき	○松井貴一、石川久美子、井上浩徳、三浦修平、小岩一郎、本間英夫
無電解ニッケルめっきにおける下地アルミニウムの表面状態	○配島雄樹、齋藤裕一、柳沢英夫、田代雄彦、小岩一郎、本間英夫
エッチングを必要としない平滑基板上への無電解めっき	○井上浩徳、石川久美子、林亮、小岩一郎、本間英夫
大型UV処理装置を用いたクロムフリーABS樹脂めっき方法	○清田浩之、杉本将治、田代雄彦、別所毅、小岩一郎、本間英夫
光触媒を用いたABS樹脂の改質効果	○杉本将治、田代雄彦、別所毅、小岩一郎、本間英夫
無電解Ni-PめっきのP偏析における各種錯化剤の影響	○有田匡史、齋藤裕一、田代雄彦、山下嗣人、本間英夫
第20回エレクトロニクス実装学会講演大会 (2006、3 日本大学)	
不溶性アノードを用いた硫酸銅めっき浴の検討	○萩原秀樹、君塚亮一、小岩一郎、本間英夫
厚付け置換型ノーシアン金めっきの検討	○寺島肇、長島弘季、角田貴徳、小林未奈子、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
UV改質処理を用いたポリイミド上への無電解めっき法	○石川久美子、松井貴一、井上浩徳、三浦修平、小岩一郎、本間英夫
高アスペクト比スルーホールへの無電解銅めっきの適応	○井上浩徳、王子雅裕、樋口峰進、小山田仁子、宮崎智行、依田健太郎、本間英夫
めっき皮膜のin-situ応力測定	○小山田仁子、本橋甲子明、高橋智賀子、秋山勝徳、山本渡、小岩一郎、本間英夫
大型UV装置を用いたABS樹脂の改質処理	○田代雄彦、清田浩之、杉本将治、別所毅、小岩一郎、本間英夫
電気化学会第73回大会 (2006、4 首都大学東京)	
ピアフィリングに及ぼす添加剤消費の影響	○小田倉尚子、長島弘季、小山田仁子、杉本将治、小岩一郎、本間英夫
ICEP2006 (International Conference on Electronics Packaging) (2006.4 Shinagawa Prince Hotel, Tokyo Japane)	
Effect of Under Layer Nickel Plating on the Properties of Electroless Palladium and Gold Films	○Hajime TERASHIMA、Hiroki NAGASHIMA、Takanori TSUNODA、Hideto WATANABE、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
日本接着学会第44回年次大会講演(2006、6-7)	
めっき法と光触媒を用いた低環境負荷接着技術	○小岩一郎、井上浩徳、田代雄彦、本間英夫
樹脂と接着性向上の為のアルミニウム表面粗化法	○渡辺充広、石田卓也、本間英夫、小岩一郎
56th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (2006.8 Edinburgh, England)	
Influence of Under Layer on Properties of Electroless Deposited Gold	○Ichiro KOIWA、Takanori TSUNODA、Hajime TERASHIMA、Hideto WATANABE、Hideo HONMA
Surface Modification of Polyimide Using UV for the Metallization	○Koutoku INOUE、Kumiko ISHIKAWA、Syuhei MIURA、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
Influence of Accelerator Consumption to the Filling of Copper by Electroplating	○Shoko ODAKURA、Masaharu SUGIMOTO、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
電気学会 電子・情報・システム部門大会(2006.9 関東学院大学)	
高アスペクト比スルーホールに適応した無電解銅めっき法	○王子雅裕、樋口峰進、井上浩徳、宮崎智行、依田健太郎、小岩一郎、本間英夫
電気化学測定を用いた硫酸銅めっき浴の検討	○萩原秀樹、君塚亮一、小岩一郎、本間英夫
ABS樹脂へのクロムフリーエッチング代替処理	○田代雄彦、杉本将治、別所毅、小岩一郎、本間英夫

光触媒を前処理に適した絶縁樹脂上への無電解銅めっき	○井上浩徳、石川久美子、渡辺充広、小岩一郎、本間英夫
アルミニウム上への置換ニッケルめっきに関する検討	○齋藤裕一、配島雄樹、田代雄彦、小岩一郎、本間英夫
放熱プリント回路基板における樹脂との接着性向上の為のアルミニウム表面粗化方法	○渡辺充広、石田卓也、本間英夫、小岩一郎
めっき法による3次元構造体の作成	○中丸弥一郎、三隅浩一、小岩一郎、本間英夫
スパッタ膜形成条件による金めっきへの影響	○三隅浩一、先崎尊博、鷲尾泰史、齋藤宏二、本間英夫
第114回表面技術協会学術講演大会 (2006、10 北海道大学)	
無電解Ni-PめっきのP偏析における各種錯化剤の影響	○有田匡史、齋藤裕一、田代雄彦、山下嗣人、本間英夫
無電解Au/Pd/Niめっきプロセスにおける下地無電解Niめっき皮膜の重要性	○渡辺秀人、村松健、齋藤裕一、寺島肇、小岩一郎、本間英夫
無電解Ni/Auめっきにおけるボンディング特性におよぼすNi-P皮膜の影響	○寺島肇、齋藤裕一、村松健、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
ニオブのナノパウダーを使用した分散めっきとその熱処理特性	
光触媒による表面改質を用いた導電性微粒子の作製	○石川久美子、井上浩徳、小岩一郎、本間英夫
ガラス上への直接無電解銅めっきを用いた回路形成	○齋藤裕一、清田浩之、和久田陽平、本間英夫
UVによる表面改質処理法を用いたポリイミド上へのメタライジング	○松井貴一、石川久美子、井上浩徳、小岩一郎、本間英夫
光触媒によるABS樹脂改質メカニズム	○杉本将治、田代雄彦、別所毅、小岩一郎、本間英夫
高アスペクト比スルーホールへの無電解銅めっき	○樋口峰進、王子雅裕、井上浩徳、宮崎智之、依田健太郎、小岩一郎、本間英夫
第16回 マイクロエレクトロニクスシンポジウム (2006、10 大阪大学)	
UV改質処理を用いたポリイミド上への金属薄膜形成	○井上浩徳、石川久美子、渡辺充広、小岩一郎、本間英夫
無電解Ni-P,Pd,Auめっき薄膜とワイヤーボンディング特性の相関性の研究	○齋藤裕一、寺島肇、村松健、渡辺秀人、小岩一郎、本間英夫
置換法におけるアルミニウム電極上へのフッ化水素酸フリーエッチング	○配島雄樹、齋藤裕一、柳澤英夫、田代雄彦、小岩一郎、本間英夫
Eco Design 2006 Asia Psific Symposium (2006、12学術情報センター)	
Surface Modification of Insulating Resin for Build-up Process using TiO2 as Photo-catalyst	○Hideo Honma, Kotoku Inoue, Ichiro Koiwa
第20回高密度実装技術セミナー (2007、3 横浜国立大学)	
ワイヤーボンディング特性に及ぼす下地無電解ニッケルめっきの影響	○小岩一郎、磯崎裕一、和久田陽平、寺島肇、斉藤祐一、村松健、渡辺秀人、本間英夫
IT社会とめっき技術	○小岩一郎、本間英夫
第115回表面技術協会学術講演大会 (2007、3 芝浦工業大学)	
ジンケートフリーを目的としたAl合金上への直接電気Niめっき	○貝塚聡、和久田陽平、齋藤裕一、渡辺充広、小岩一郎、本間英夫
UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマーへのメタライジング	○松井貴一、杉本将治、渡辺充広、本間英夫
MgのNiめっきにおける置換法の適用	○福田雅宏 配島雄樹 小岩一郎 本間英夫
UVによる改質処理を用いた液晶ポリマー上への無電解めっき	○飯森陽介、松井貴一、石川久美子、井上浩徳、渡辺充広、本間英夫
無電解銅めっき用Cu混合触媒法	○井上浩徳、渡辺充広、本間英夫
HPLCによる促進剤の分解挙動の分析	○中島光志、小田倉尚子、吉水裕貴、杉本将治、香西博明、本間英夫
スルファミン酸ニッケル浴中のホウ酸フリーの検討	○和久田陽平、田代雄彦、渡辺充広、小岩一郎、本間英夫
第21回エレクトロニクス実装学会講演大会 (2007、3 早稲田大学)	

シクロオレフィンポリマーへの平滑回路形成	○渡辺充広、杉本将治、松井貴一、本間英夫
電気化学会第74回大会 (2007、3 東京理科大学)	
ニオブナノ粒子を用いた無電解反応性分散めっきの熱処理挙動	○配島雄樹、小岩一郎、本間英夫
ニオブナノ粒子を用いた無電解反応性分散めっきの合金化過程	○小岩一郎、配島雄樹、杉山武晴、本間英夫
ICEP2007 (International Conference on Electronics Packaging) (2007.4 Shinagawa Prince Hotel, Tokyo Japan)	
Effect of Underlayer Ni-P Film on the Wire Bonding Properties of Electroless Au/Pd/Ni-P Films	○Yuichi SAITO、Hajime TERASHIMA、Takeshi MURAMATSU、Hideto WATANABE、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
A Study on the Method to Embed the Thin Film Capacitor Array Fabricated by Semiconductor Technology	○Mitsuhiro WATANABE、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA、Kinya ASHIKAGA、Makoto TERUI
Effect of Underlying Nickel Films on Wire Bondability of Electroless Gold Film	○Yohei WAKUDA、Hajime TERASHIMA、Yuichi SAITO、Takeshi MURAMATSU、Hideto WATANABE、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
Surface Modification of Polyimide Films Using UV Irradiation for Fine Pattern Fabrication	○Kiichi MATSUI、Kumiko ISHIKAWA、Kotoku INOUE、Mitsuhiro WATANABE、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
よこはま高度実装技術コンソーシアム 創立一周年記念 (2007、9 新横浜国際ホテル)	
無電解Ni-P/Auめっきにおける中間バリア層がワイヤーボンディング特性に及ぼす影響	○和久田陽平、吉田康平、本間景虎、小岩一郎、本間英夫
第17回 マイクロエレクトロニクスシンポジウム (2007、9 甲南大学)	
無電解めっきを用いたFPCとITOの新しい接続方法	○和久田陽平、渡辺充広、小岩一郎、大倉啓幸、川手恒一郎、安井秀明、本間英夫
金/銅パッド間への無電解三元合金中間層の挿入がワイヤーボンディング特性に及ぼす影響	○本間景虎、小岩一郎、和久田陽平、本間英夫
第116回表面技術協会学術講演大会 (2007、9 長崎大学)	
各種金めっき皮膜のピンホール試験法に関する検討	○中島光志、加藤友人、井上浩徳、渡辺秀人、本間英夫
Pd混合触媒に代わるCu混合触媒の検討	○井上浩徳、渡辺貴史、渡辺充広、本間英夫
FPCとITOの接合に優れた無電解めっき法	○福田雅宏、和久田陽平、渡辺充広、小岩一郎、大倉啓幸、川手恒一郎、安井秀明、小杉活充、本間英夫
ガラス上への無電解Ni-Pめっきのフォトマスクへの応用について	○岨野公一、森田茂樹、半田昌一、○高橋 孝、小岩一郎
UVによる改質処理を用いた液晶ポリマー上への無電解めっき	○飯森陽介、松井貴一、杉本将治、石田卓也、渡辺充広、本間英夫
クロムスパッタの代替を目的としたウェットプロセスによるフォトマスクの作製	○清田浩之、齋藤裕一、金田龍馬、杉山武晴、小岩一郎、本間英夫、岨野公一
W-CSPにおけるピアフィリングの検討	○和久田陽平、金森元気、浦嶋巖将、八重樫良平、藤崎純史、田村俊夫、山田忠昭、渡辺充広、小岩一郎、本間英夫
電気Niめっき皮膜の物理的・機械的特性	○平井洋考、貝塚聡、和久田陽平、中丸弥一郎、渡辺充広、本間英夫
212th ECS (Meeting of The Electrochemical Society, Inc.) (2007 10, Washington DC ,USA)	
Effect of New Electroless Nickel Alloy Films as Intermediate Layer on Au/Ni-P Films	○Ichiro KOIWA、Yohei WAKUDA、Takeshi MURAMATSU、Hideto WATANABE、Hideo HONMA
Alloy Formation Process of Reactive Electroless Composite Plating Film Using Niobium Nano-powder	○Yuki HAIJIMA、Takeharu SUGIYAMA、Ichiro KOIWA、Hideo HONMA
Surface Modification of Polyimide Using UV for the Metallization	○Kiichi MATSUI、Kotoku INOUE、YoungGwan KO、Mitsuhiro WATANABE、Hideo HONMA
第117回表面技術協会学術講演大会 (2008、3 日本大学)	

MEMS技術への適用を目的とした電気Ni皮膜の物性評価	○高橋徹、貝塚聡、中丸弥一郎、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
下地Niへの各種皮膜におけるピンホール試験法に関する検討	○加藤友人、中島光志、井上浩徳、斉藤裕一、渡辺秀人、本間英夫
フォトリソへの応用を目的としたガラス上への無電解Niめっき	○金田龍馬、清田浩之、齋藤裕一、高橋孝、堀野公一、小岩一郎、本間英夫、
PEG誘導体を用いたビア・スルーホール混在基板上への電気銅めっき	○小林正樹、中島光志、松原敏明、杉本将治、井上浩徳、香西博明、本間英夫、
樹脂粒子によるスズ皮膜の耐摩耗性の向上	○馬場邦人、鈴木貴樹、石田卓也、坂喜文、本間英夫
UV改質処理を用いたエポキシ系樹脂へのメタライズング	○飯森陽介、井上浩徳、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
無電解ニッケルめっきにおけるピット、ノジュールについて	○糸谷辰幸、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
UVおよびTiO ₂ を用いたABS樹脂の改質効果	○杉本将治、田代雄彦、別所毅、小岩一郎、本間英夫

第22回エレクトロニクス実装学会講演大会 (2008、3 東京大学)

UV照射を前処理として用いたエポキシ系樹脂へのメタライゼーション	○清田浩之、井上浩徳、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
PETフィルム上への密着性に優れた導電層形成方法	○松井貴一、木村佳子、太田哲司、渡辺充広、本間英夫

INTERFINISH 2008 – 17Th World Congress & Exposition (2008、6釜山)

Surface Modification of Insulating Resin by UV light for Preparation of Fine Circuit Patterns	Hideo Honma
Reactive Composite Film Plated with Nano-powder and Their Alloying Behavior	Yuki Haijima, Takeharu Sugiyama, Ichiro Koiwa, Hideo Honma
Evaluation of Tin-Cu Mixed Catalyst for the Replacement of Tin-Pd Mixed Catalyst	Kotoku Inoue, Kunihito Baba, Mitsuhiro Watanabe, Hideo Honma
Fabrication of Photo Mask by Electroless Ni-P Plating on Glass Substrate	Tatsuma Kaneda, Hiroyuki Seida, Yuichi Saitou, Takashi Takahashi, Koichi Sono, Ichirou Koiwa, Hideo Honma
Characterization of Nickel Deposits for Fabrication of Micro Structure by Electro Nickel Plating	Satoshi Kaizuka, Toru Takahashi, Yaichirou Nakamaru, Katuhiko Tashiro, Mitsuhiro Watanabe, Hideo Honma
Formation of Fine Circuit Patterns on Liquid Crystalline Polymer Film	Yosuke Iimori, Kotoku Inoue, Atsushi Kosuge, Masaharu Sugimoto, Takuya Isida, Mitsuhiro Watanabe, Hideo Honma
Electroless Copper Plating on Cycloolefin Polymer Using UV Irradiation as Pretreatment	Tatsuyuki Joya, Atsushi Kosuge, Masaharu Sugimoto, Mitsuhiro Watanabe, Hideo Honma
Application of Electroless Copper Plating for High Aspect Through-Holes	Koji Nakajima, Koutoku Inoue, Hideo Honma
Wear Resistance Improvement of Tin Film by PTFE Particles	Kunihito baba, Takaki Suzuki, Takuya Ishida, Yoshifumi Saka, Yasuhiro Hattori, Hideo Honma
Plating with Copper Sulfate Bath Using an End-Modified PEG Compound.	Masaki Kobayashi, Kouji Nakajima, Toshiaki Matubara, Masaharu Sugimoto, Hiroaki Kouzai, Hideo Honma
Influence of Polyethylene Glycol Derivatives for Copper Electroplating	Toshiaki Matsubara, Masaki Kobayashi, Masaharu Sugimoto, Hideo Honma, Hiroaki Kouzai
Fabrication of 3-Dimensional Microstructure by Plating and Photolithography.	Yaichirou Nakamaru, Kouichi Misumi, Hideo Honma
Pinhole Detection Method For Gold Films Plated Over a Ni-P Film	Tomohito Katou, Koji Nakajima, Koutoku Inoue, Hideto Watanabe, Hideo Honma

第118回表面技術協会学術講演大会 (2008、9近畿大学)

UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマー上へのメタライゼーション	○飯森陽介、井上浩徳、杉本将治、渡辺充広、本間英夫
ポロンドープダイヤモンドを利用しためっき添加剤の分析	○西谷伴子、川口明廣、本間英夫

Electro Chemical Society -PRIME2008(2008、10 Hawaii)

Surface Metallization on Liquid Crystalline Polymer Film by Means of UV Irradiation Reforming Process	○Takeharu SUGIYAMA、Yosuke IIMORI、Kotoku INOUE、Mitsuhiro WATANABE、Hideo HONMA
Evaluation of Tin-Copper Mixed Catalyst for the Replacement of tin-palladium Mixed Catalyst for Electroless plating	○Koutoku INOUE、Kunihito BABA、Takeharu SUGIYAMA、Mitsuhiro WATANABE、Hideo HONMA
The Application Plating on Photoresist for MEMS Micro Structure	○Kunihito BABA、Yaichirou NAKAMARU、Koichi MISUMI、Hideo HONMA
Uniformity of Electroless Copper Plating for High Aspect Through-Holes in PCB	○Koji NAKAJIMA、Kotoku INOUE、Hideo HONMA
第23回エレクトロニクス実装学会(2009.3 関東学院大学)	
各基板材料への高密着シード層めっきの形成	○金森元気、田中慎也、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
PEG誘導体を用いたスルーホールフィリングに関する検討	○中島光志 小林正樹 中村健太郎 松原敏明 杉本将治 本間英夫
UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマーフィルム上へのメタライジング	○西村宜幸、飯森陽介、渡辺充広、本間英夫
PEG誘導体を用いた電気めっき浴のピア・スルーホールへの適応	○小林正樹、松原敏明、中島光志、杉本将治、本間英夫
UV改質処理を用いたポリイミド上へのメタライジング	○飯森陽介、西村宜幸、渡辺充広、本間英夫
ジンケートフリーのアルミ上への高密着めっき	○金田龍馬、貝塚聡、齋藤裕一、渡辺充広、本間英夫
樹脂粒子による錫皮膜の耐摩耗性の向上	○林貴之、鈴木貴樹、馬場邦人、石田卓也、坂喜文、本間英夫
MEMS構造に対応した感光性樹脂上へのめっきの応用	○馬場邦人、中丸弥一郎、三隅浩一、本間英夫
電気めっきによるマイクロカンチレバーのための機能性材料の創製	○貝塚聡、和田浩史、和久田陽平、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
耐バリア性に優れた無電解Pd合金皮膜	○加藤友人、浅沼雄貴、寺島肇、渡邊秀人、本間英夫
各種PEG誘導体を用いたスルーホールフィリングにおける電気化学的観察とその有効性の評価	○中村健太郎、小林正樹、中島光志、松原敏明、杉本将治、本間英夫
高速伝送分野を視野に入れた各基板材料への高密着シード層めっきの形成	○田中慎也、金森元気、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
MEMSへの応用を目的とした電気Ni合金めっきによる機能性皮膜の開発	○和田浩史、貝塚聡、和久田陽平、田代雄彦、菅野哲也、本間英夫
UV改質処理を用いた樹脂上への選択的析出及び異方性成長	○谷谷辰幸、中丸弥一郎、井上浩徳、田代雄彦、本間英夫
無電解めっき用Cu混合触媒を用いた絶縁樹脂上へのメタライジング	○井上浩徳、馬場邦人、渡辺充広、本間英夫
第119回表面技術協会学術講演大会(2009.3山梨大学)	
ホウ酸フリー型スルファミン酸Ni浴によるコンポジットめっき	○中丸弥一郎、和久田陽平、田代雄彦、本間英夫
ピア・スルーホール基板へのPEG誘導体を用いた電気銅めっきの検討	○和久田陽平、小林正樹、松原敏明、中島光志、杉本将治、本間英夫
耐バリア性に優れた無電解Pd合金皮膜の特性	○浅沼雄貴、加藤友人、寺島肇、渡邊秀人、本間英夫
錫皮膜の耐摩耗性向上を目的とした複合めっき	○鈴木貴樹、林貴之、馬場邦人、石田卓也、坂喜文、本間英夫
アカデミックプラザ (JPCA_2009.6東京ビックサイト)	
各基板材料への高密着シード層めっきの形成	○金森元気、西村宜幸、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
樹脂およびめっき皮膜との密着性に優れたアルミニウム合金表面処理法	○金田龍馬、貝塚聡、齋藤裕一、渡辺充広、本間英夫
第120回表面技術協会学術講演大会(2009.9幕張メッセ)	
ホウ酸フリースルファミン酸ニッケルめっき浴の諸特性の検討	○吉田康平、和田浩史、和久田陽平、田代雄彦、本間英夫
UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマーフィルム上へのメタライゼーション	○西村宜幸、馬場邦人、渡辺充広、本間英夫
各基板材料への高密着シード層めっきの形成	○田中慎也、金森元気、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫

無電解めっきの異方性成長による直接配線形成技術とその解析	○中丸弥一郎、田代雄彦、本間英夫
Cu混合触媒溶液を用いた絶縁樹脂上へのメタライジング	○加藤友人、加藤育洋、渡辺充広、本間英夫
第121回表面技術協会学術講演大会(2010.3成蹊大学)	
環境調和型外装品めっきの可能性	○馬場邦人、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
スルーホールフィリングにおけるPEG誘導体の効果	○西尾雅人、小林正樹、杉本将治、本間英夫
高硬度電気ニッケル皮膜の作製	○和田浩史、和久田陽平、田代雄彦、本間英夫
絶縁樹脂上への高密着皮膜の形成	○田中慎也、金森元気、渡辺充広、本間英夫
コンポジットめっきにおける共析因子の影響	○和久田陽平、中丸弥一郎、田代雄彦、本間英夫
ホウ酸フリースルファミン酸ニッケルめっき浴を用いた微細構造体作製	○吉田康平、和久田陽平、田代雄彦、本間英夫
第24回エレクトロニクス実装学会(2010.3芝浦工業大学)	
ガラスエポキシ樹脂を用いた高密着シード層めっきの形成	○金森元気、田中慎也、渡辺充広、本間英夫
硫酸銅めっき浴によるスルーホールフィリングの検討 - Investigation of Copper Filling Using Coppers Sulfate bath	○小林正樹、丸山貴昭、杉本将治、香西博明、本間英夫
無電解めっきにおけるCuを用いた触媒法	○加藤友人、加藤育洋、馬場邦人、渡辺充広、本間英夫
ビアフィリングのめっき成長メカニズム	○和久田陽平、杉本将治、渡辺充広、本間英夫
大気UV処理を用いたエポキシ樹脂への平滑めっき	○金田龍馬、杉本将治、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマーフィルム上へのメタライジング	○西村宜幸、馬場邦人、渡辺充広、本間英夫
(論文賞受賞記念講演回)	
Pd混合触媒に代わる無電解めっき用Cu混合触媒の検討	○井上浩徳、馬場邦人、杉山武晴、渡辺充広、本間英夫
ICEP2010 (Sapporo Conventional Center Hokkaido JAPAN)	
Influences of the Electroless Nickel Film Morphology on the Electroless Au/Pd/Ni	○Kuhiro Kato, Tomohito Kato, Hajime Terashima, Hideto Watanabe, Hideo Honma
Formation of Fine Circuit Patterns on Cyclo Olefin Polymer Film	○K.BABA, Y.NISHIMURA, M.WATANABE, H.HONMA
第21回 社団法人 プラスチック成型加工学会 (2010.6.2)	
プラスチック導波管の表面改質によるめっき密着力および高周波特性の向上	(三菱電気) ○遠藤康博、湯川秀憲、濱野浩司、(関東学院大) 渡辺充広、(表面工学研究所、関東学院大) 本間英夫
電子機器向け銅めっきシクロオレフィンポリマー基盤の開発	(日本ゼオン) ○棚橋直樹、多田充、田中公章、(表面工学研究所) 渡辺充広、(表面工学研究所、関東学院大) 本間英夫
第122回表面技術協会学術講演大会(2010.9東北大学)	
UV改質を用いた液晶ポリマー上へのメタライジング	○田中慎也、馬場邦人、杉本将治、渡辺充広、本間英夫
電気ニッケルめっきによる高速めっきの検討	○和久田陽平、加藤育洋、田代雄彦、本間英夫
UV処理を用いた異方性無電解めっきによるレジストレス配線形成	○新城沙耶加、馬場邦人、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
無電解ニッケルめっき皮膜の撥水性に及ぼす諸因子の影響	○和田浩史、和久田陽平、田代雄彦、本間英夫
MES2010 第20回 マイクロエレクトロニクスシンポジウム	
ビアフィリングの銅めっき成長機構	○和久田陽平、杉本将治、渡辺充広、山下嗣人、本間英夫
平成22年度 神奈川県ものづくり技術交流会(2010.10 神奈川県技術交流センター)	

ジンケートフリーのアルミニウムへの電気ニッケルめっき	○和久田陽平、馬場邦人、齋藤裕一、渡辺充広、本間英夫
UV照射を前処理とした樹脂上への無電解めっき	○馬場邦人、杉本将治、田代雄彦、本間英夫
ニッケルめっき皮膜の撥水性に及ぼす浴組成の影響	○和田浩史、和久田陽平、加藤育洋、田代雄彦、本間英夫
スルーホールファイリングにおけるPEG誘導体の効果	○西尾雅人、大久保賢、和久田陽平、杉本将治、香西博明、本間英夫
UV処理法を用いた無電解めっきによる直接配線形成法	○新城沙耶加、馬場邦人、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
The 9th International Symposium on Microelectronics and packaging (Oct 13-14, 2010 korea)	
Surface Modification of Insulation Resin by UV light for Preparation of Fine Circuit Patterns	○Hideo Honma
2010 KISE Fall Meeting & International Symposium(2010.11)	
Influences of Electroless Nickel Film Condition on Electroless Au/Pd/Ni Wire Bondability	○Ikuhiro KATO, Tomohito KATO, Hajime TERASHIMA, Hideto WATANABE, Hideo HONMA
Surface modification of resin substrate by UV treatment for printed circuit board	○Kunihito BABA, Yoshiyuki NISHIMURA, Mitsuhiro WATANABE and Hideo HONMA
第123回表面技術協会学術講演大会(2011.3 関東学院大学)	
電気ニッケルめっきの高速化の検討	○和久田陽平、加藤育洋、田代雄彦、本間英夫
電解Au/Pd/NiめっきのためのPd-P皮膜の作製	○加藤育洋、浅沼雄貴、村上祥教、渡邊秀人、本間英夫
変性ポリフェニレンエーテル材への無電解めっき	○馬場邦人、田代雄彦、渡辺充広、西口賢治、本間英夫
Au/Pd/Niめっきのための電解Pd-P合金皮膜の作製	○浅沼雄貴、加藤育洋、村上祥教、渡邊秀人、本間英夫
UVプロセスによる平滑樹脂上への高密着銅皮膜の形成	○田中慎也、鈴木慎二、馬場邦人、杉本将治、渡辺充広、本間英夫
異方性無電解めっきによる樹脂上への直接配線形成法	○新城沙耶加、馬場邦人、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
ラジカル水を用いた表面改質	○鈴木慎二、田中慎也、馬場邦人、田代雄彦、本間英夫
第25回エレクトロニクス実装学会(2011.3 横浜国立大学)	
硫酸銅めっきにおけるピアファイリングの添加剤挙動の検討	○和久田陽平、杉本将治、渡辺充広、山下嗣人、本間英夫
電解Au/Ni皮膜の耐食性向上を目的とした下地ニッケル合金めっきの適用	○加藤育洋、村上祥教、渡邊秀人、本間英夫
ミリ波透過性を有する無電解ニッケルめっき皮膜の形成	○馬場邦人、渡辺充広、北村佳子、高橋順子、本間英夫
異方性無電解Cuめっきを用いた回路パターン形成法	○新城沙耶加、馬場邦人、田代雄彦、渡辺充広、本間英夫
62nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (2011.11 Niigata)	
Pattern formation by Anisotropic Electroless Plating Using Selective UV irradiation Pretreatment	○Kunihito BABA, Sayaka ARASHIRO, Yoshiyuki NISHIMURA, Chris CORDONIER, Hideo HONMA
Development of Electro Pd-P Plating Bath for PPF Process	○Ikuhiro KATO, Yoshinori MURAKAMI, Hideto WATANABE, Hideo HONMA
Surface Analysis of Additive Influence on Electrodeposition of Copper in Via-filling Using an Electrochemical Probe (SECM)	○Christopher Cordonier, Tsugito Yamasita, Hideo Honma
第124回表面技術協会学術講演大会(2011.9 名古屋大学)	
電解金めっき皮膜の成膜性に対する下地ニッケル皮膜の影響	○加藤育洋、村上祥教、渡邊秀人、本間英夫
平成23年度 神奈川県ものづくり技術交流会(2011.11)	
新規プリント配線形成技術の開発	○馬場邦人、新城沙耶加、本間英夫
ラジカル水を用いた表面改質法	○鈴木慎二、岡部恭平、山崎彬、田代雄彦、本間英夫、山下嗣人

スルファミン酸ニッケル浴における金属不純物混入時の影響	○井出健太、加藤 育洋、本間英夫
The 15th International Conference on Thin Films(2011.11)	
Anisotropic Electroless Plating Growth for Resist-less Pattern Formation	○Sayaka ARASHIRO、Kunihito BABA、Christopher E.J. CORDONIER、Hideo HONMA
第125回表面技術協会学術講演大会(2012.3 東京都市大学)	
無電解Ni-P-SiCコンポジットの基礎的研究	○岡部恭平、高木道則、梅田泰、田代雄彦、本間英夫
パラジウムの代替として銅を無電解めっきの触媒に用いた配線形成	○堀内義夫、馬場邦人、本間英夫、山下嗣人
オゾンマイクロ・ナノバブルによる表面改質	○渡邊沙織、田代雄彦、梅田泰、本間英夫、山下嗣人
異方性無電解めっきを用いたレジストレスパターン形成	○新城沙耶加、馬場邦人、Christopher E.J. CORDONIER、本間英夫
平成24年度日本材料科学会学術講演大会講演(2012.6 工学院大学)	
末端修飾ポリエチレングリコール誘導体の調製およびスルーホールフィリングへの応用	○大久保賢、石井一史、コルドニエ クリス、山下嗣人、香西博明
第19回材料化学若手研究者討論会(2012.9 横浜国立大学)	
PEG誘導体のスルーホールめっきによる評価における添加効果	○大久保賢、鈴木健太、コルドニエ クリス、本間英夫、香西博明
表面技術協会第126回講演大会(2012.9 室蘭工業大学)	
オゾンマイクロ・ナノバブル水によるPlの表面改質	○渡邊沙織、西村宜幸、田代雄彦、梅田泰、本間英夫、山下嗣人
フォトソルを用いたガラス基板上への回路形成の検討	○加賀美貴洋、C. Cordonier、本間英夫、山下嗣人
ホウ酸フリー次亜リン酸銅めっき浴の検討	○岡部恭平、西村宜幸、C・Cordonier、本間英夫、山下嗣人
マテリアルライフ学会第17回春期研究発表会(2013.3 品川インターシティ)	
スルーホールフィリングにおけるPEG誘導体の添加効果	○大久保賢、石井一史、コルドニエ クリス、本間英夫、香西博明
電気銅めっきにおける回路パターン形成	○石井一史、大久保賢、コルドニエ クリス、本間英夫、香西博明
表面技術協会第127回講演大会(2013.3 日本工業大学)	
オゾンマイクロ・ナノバブル水によるABSの表面改質	○渡邊沙織、西村宜幸、田代雄彦、梅田泰、本間英夫、山下嗣人
結晶Si太陽光電池基板上への銅電極作製	○出口和樹、本間英夫、梅田泰、ウインモーソー、坂田功、高遠秀尚
カップスタック型CNTを用いた無電解NiPコンポジットめっき	○土屋佑真、岡崎晃生、田代雄彦、梅田泰、本間英夫
優れた耐食性を有する無電解Ni-Sn-P合金めっきの開発	○須藤裕太、田代雄彦、本間英夫、山下嗣人
ポリプロピレンへの表面改質	○鈴木慎二、西村宜幸、田代雄彦、梅田泰、本間英夫、山下嗣人
SiCを用いたNi-Pコンポジットめっき	○樫村賢治、吉野正洋、田代雄彦、梅田泰、本間英夫
PEG誘導体を用いたスルーホールフィリング	○大久保賢、石井一史、Christopher E.J. CORDNIER、本間英夫、香西博明
不飽和ポリエステルへの表面改質	○梅本博史、渡邊沙織、田代雄彦、梅田泰、高井治、本間英夫
International Symposium on Highly-Controlled Nano- and Micro-Scale Functional Surface Structures for Frontier Smart Materials 2013(2013.4 Kanto Gakuin University)	
3D Pattern Bridge Construction Using Photo-acid Generating Metal Complexes	○Hitoshi Endo, O. Takai, H. Honma, and Christopher E. J. Cordonier
Stress Control in High-Speed Plating of Nickel Bath	○Sojiro Kirihara, O. Takai, Y. Umeda, K. Tashiro and H. Honma
Surface Modification of SiC Particles for Composite Plating	○Kenji Kashimura, M. Yoshino, M. Sone, K. Tashiro, Y. Umeda and H. Honma

The 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim, and OptoElectronics and Communications Conference / Photonics in Switching 2013(CLEO&OECC) (2013.7 Kyoto International Conference Center)

Potential-Tailored Strained InGaAs Quantum Well for Polarization-Dependent Optical Switch	OH. Tominaga, J.-H. Noh and T. Arakawa
---	--

International Conference on Materials Energy and Environments (ICMEE) (2013.8 Kanto Gakuin University)

3D Pattern Bridge Construction Using Photo-acid Generating Metal Complexes	OHitoshi Endo, O. Takai, H. Honma, and Christopher E. J. Cordonier
--	--

Stress Control in High-Speed Plating of Nickel Bath	OSojiro Kirihara, O. Takai, Y. Umeda, K. Tashiro and H. Honma
---	---

電子情報通信学会 OPE研究会(2013.8 サンリフレ函館)

InGaAs ポテンシャル制御量子井戸を用いた偏光無依存2X2光スイッチの理論検討	○富永 寛輝、盧 柱亨、荒川太郎
---	------------------

第74回応用物理学学会学術講演会(2013.9 同志社大学)

電界不均一性を考慮した五層非対称量子井戸組み合わせ構造の最適化と光位相変調器への応用	○関口 徹、盧 柱亨、荒川太郎
--	-----------------

電界制御型分岐比可変多モード干渉カプラーの作製	○川崎直道、盧 柱亨、荒川太郎
-------------------------	-----------------

表面技術協会第128回講演大会(2013.9 福岡工業大学)

UVおよびVUV照射による樹脂への表面改質効果	○折地紗由里、梅田泰、高井治、本間英夫
-------------------------	---------------------

オゾンマイクロ・ナノバブル水によるPIの表面改質	○横田恭子、田代雄彦、梅田泰、高井治、本間英夫
--------------------------	-------------------------

UVを用いたPPへの表面改質	○豊田紘嗣、木村秀樹、田代雄彦、梅田泰、高井治、本間英夫
----------------	------------------------------

DLCコーテッドゴムの表面形態による摩擦・摩耗の低減	○藤邨克之、村木正芳、中村健太、高井治
----------------------------	---------------------

次亜リン酸塩を還元剤とする無電解銅めっきにおける添加剤の効果	○岡部恭平、田代雄彦、本間英夫、山下嗣人
--------------------------------	----------------------

無電解めっき触媒を指向した塩基性アミノ酸Pd(II)錯体の吸着性能	○高德 誠、高井治
-----------------------------------	-----------

Auめっき表面の形態制御とその諸特性	○西村宜幸、前原麻利子、本間英夫、山下嗣人
--------------------	-----------------------

高密度プラズマアシスト蒸着により作製したSiO ₂ 薄膜およびNb ₂ O ₅ 薄膜の光学的・機械的特性	○森泉 康、高井治
---	-----------

感光性錯体を用いたガラス上への直接回路パターンめっきの形成	○遠藤仁志、本間英夫、高井治、C. E. J. Cordonier
-------------------------------	-----------------------------------

高機能性樹脂への転写パターン形成	○堀内義夫、加賀美貴洋、Christopher E.J. Cordonier、本間英夫
------------------	---

平成25年度 神奈川県ものづくり技術交流会(2013.10 神奈川県技術交流センター)

還元剤として次亜リン酸塩を用いた無電解銅めっきにおける添加剤の効果	○岡部恭平、田代雄彦、本間英夫、山下嗣人
-----------------------------------	----------------------

ガラス上の転写パターン形成	○堀内義夫、加賀美貴洋、Christopher E.J. Cordonier、本間英夫
---------------	---

International Conference on Surface Engineering(2013.11 Haeundae Grand Hotel,Busan, Korea)

Frontier Plating Technology at the Materials & Surface Engineering Research Institute (Plenary Talk)	○ Hideo Honma and Christopher E. J. Cordonier
--	---

Simulation and Experiments on Control of Nanocolumnar Structure in Sputtering Process (Invited)	○ Yasushi Inoue and Osamu Takai
---	---------------------------------

Nanomaterial Syntheses by Solution Plasma Processing	○ Osamu Takai
--	---------------

Improvement of Adhesion Strength between Polyimide Film and Plated Film using Acidic Fluoride Treatment	○ Makoto KOHTOKU, Yaichiro NAKAMARU and Osamu TAKAI
Surface modification effect of resin by UV and VUV irradiation	○ Sayuri Orichi, Yasushi Umeda, Osamu Takai, Hideo Honma
Formation of Plated Metal Patterns Directly on Glass Using Photosensitive Complex	○ Hitoshi Endo, O.Takai, H. Honma, Christopher E. J. Cordonier
Study of a borate free hypophosphite copper plating bath	○ K.Okabe, C. Cordonier, H.Honma, T. Yamashita
Plated Pattern Transfer to Resin for Fabrication of Embedded Circuit	○ Yoshio Horiuchi, Takahiro Kagami, Christopher E.J. Cordonier, Osamu Takai, Hideo Honma
Photopatterning & Direct Plating	○ Christopher E.J. Cordonier, Hideo Honma

The International Symposium on Materials Science and Surface Technology (MSST) (2013.11 Kanto Gakuin University)

Surface modification effect of resin by UV and VUV irradiation	○ Sayuri Orichi, Yasushi Umeda, Hideo Honma, Osamu Takai
Formation of Selectively Plated Metal Patterns Directly on Glass Using Photosensitive Complex	○ Hitoshi Endo, O.Takai, H.Honma, Christopher E.J.Cordonier
Preparation and Evaluation of Ni-W-P/SiC Composite Coatings by Electroless Plating Method	○ Kenji Kashimura, M.Yoshino, M.Sone, K.Tashiro, Y.Umeda and H.Honma
Hardness and abrasion-resistant study of Ni-W alloy films formed using electro-deposition	○ Sojiro Kirihara, Y.Umeda, K.Tashiro, H.Honma, O.Takai
Surface Modification of Polyimide Using Ozone micro/nano Bubble Water	○ K.Yokota, K.Tashiro, Y.Umeda, O.Takai, H.Honma
Effect of additives in hypophosphite acid copper plating	○ K.Okabe, C. Cordonier, H.Honma, T. Yamashita
Plated Pattern Transfer to Resin for Fabrication of Embedded Circuit	○ Yoshio Horiuchi, Takahiro Kagami, Christopher E.J. Cordonier, Osamu Takai, Hideo Honma
Metal Oxide Film Direct Photopatterning & Direct Plating on Glass	○ Christopher E.J. Cordonier
Composite Structure of InGaAs/InAlAs Five-Layer Asymmetric Coupled Quantum Well for High-Performance Phase Modulator-Dependent Optical Switch	○ Toru Sekiguchi, JooHyong Noh and Taro Arakawa
Potential-Tailored Strained InGaAs Quantum Well for Polarization-Dependent 2X2 Optical Switch	○ Hiroki Tominaga, JooHyong Noh and Taro Arakawa
Fabrication of Electro-Optic Tunable 1X2 Multimode Interference Splitter	○ Naomichi Kawasaki, JooHyong Noh and Taro Arakawa

第3回集積光デバイスと応用技術研究会(2014.1 鬼怒川温泉ホテル)

電界制御型分岐比可変1×2量子井戸多モード干渉カプラー	○ 川崎直道、盧 柱亨、荒川太郎
-----------------------------	------------------

表面技術協会第129回講演大会(2014.3 東京理科大学)

ポリイミド変性エポキシ上へのメタライジング	○ 中林祐稀、梅田康、田代雄彦、本間英夫、香西博明
SiCコンポジット無電解ニッケルめっきの検討	○ 土谷 佑真 田代雄彦 梅田泰 齋藤隆俊 成田章浩 本間英夫
UVによる各種樹脂材料の表面改質効果	○ 尹珪宣、加賀爪元、梅田泰、盧柱亨、金榮宰、本間英夫
AIとPIが混在した基板への選択めっき	○ 岩館崇広、押切絢貴、梅田 泰、田代雄彦、高井 治、本間英夫
UV改質によるエンジニアリングプラスチックへのめっき	○ 塙 将吾、梅田 泰、田代雄彦、高井 治、本間英夫
ポリイミド上の無電解めっきにおける改質層厚が密着強度に与える影響	○ 高德 誠、中丸弥一郎、高井 治
成膜法およびゴム基材によるDLC膜の形態と摩擦特性	○ 藤邨克之、村木正芳、中村健太、高井 治

第61回応用物理学関係連合講演会(2014.3 青山学院大学)

多幅多モード干渉カプラを用いた偏波分離器の提案

○牛山大樹、盧 柱亨、荒川太郎

電界制御型分岐比可変多モード干渉カプラーのテーパ構造を用いた縮小化

○金子 慎、川崎直道、盧 柱亨、荒川太郎

日本金属学会 2014春季大会(2014.3 東京工業大学)

感光性錯体を用いたガラス上へ直接回路パターンめっきの形成

○遠藤仁志、Christopher E.J. Gondonier、本間英夫、高井治

マイクロ・ナノバブルオゾン水を用いた表面改質

○田代雄彦、梅田 泰、盧 柱亨、高井 治、本間英夫